

厚銅狭ギャップ基板 R&D

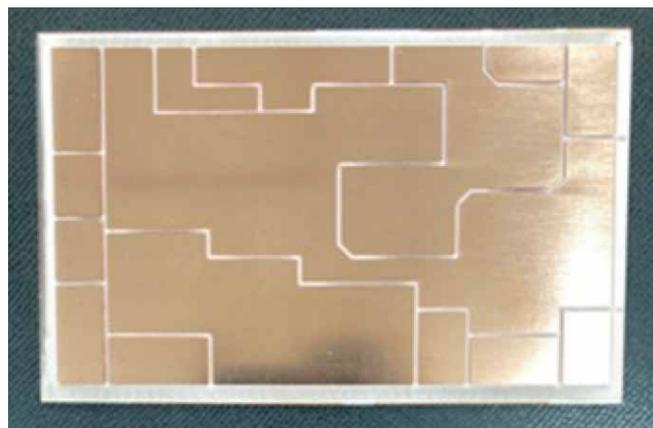
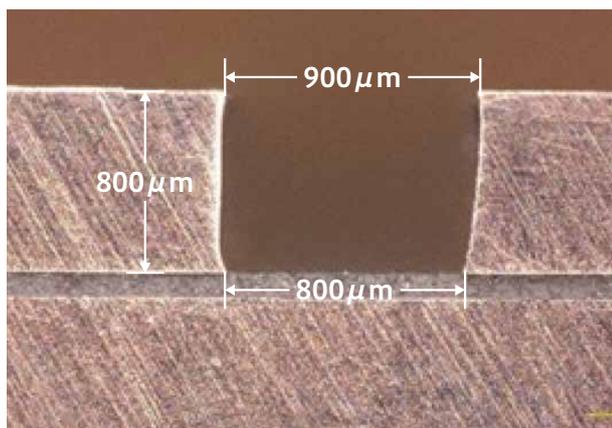
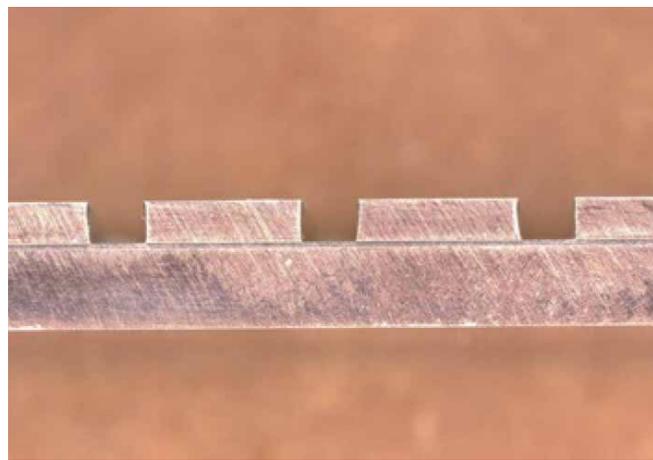
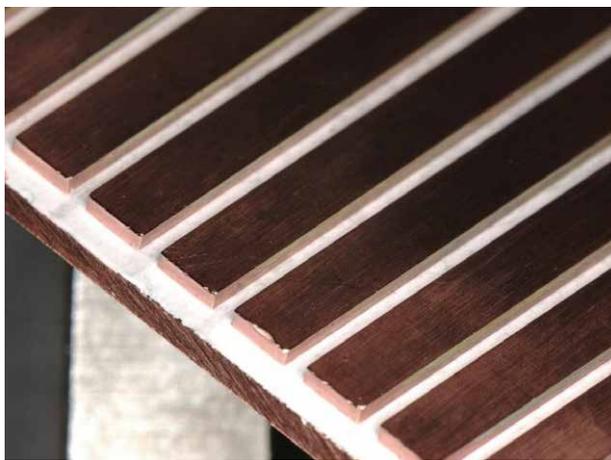
Fine gap Metal base PCB

特長 Features

- 高密度で高電流を流すことが可能
- 導体厚0.8~2.0mmでアスペクト比^{※1}: 1.0以上
- 導体厚0.8~2.0mmでエッチファクター^{※2}: 10.0以上

※1: 間隙幅/導体厚

※2: (2×導体厚) / (Top間隙幅 - Bottom間隙幅)



アプリケーション Application

- パワーデバイス基板
- コイル基板
- 電気自動車ハイブリッドモーター制御基板